

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为 2026 年半年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

公司为深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2025 年 12 月制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。2026 年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措，认真评估实施效果，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

（四）审议通过《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为消除长期租赁带来的经营不确定性、提升海外生产运营中心的稳定性，公司拟使用已终止的“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金中的 2,300 万元实施全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（马来西亚槟城金海通）的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金 1,170.52 万元永久补充流动资金。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案审议通过后，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议如下议案：

序号	审议事项
1	《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日